

第 35 回日本熱物性シンポジウム

特別ワークショップ

「高放熱性コンポジット最前線 - サーマルマネジメントの最先端を探る」

プログラム (2014年11月22日(土) 東京工業大学大岡山キャンパス 西9号館 デジタル多目的ホール)

-司会進行：森川 淳子(東工大)・安藤 慎治(東工大)-

1 プロローグ

- 10:00～10:02 開会の挨拶 花村 克悟(東工大, 第35回日本熱物性シンポジウム実行委員長)
- 10:02～10:20 高放熱性コンポジットの設計 上利 泰幸(大阪市工研)
- 10:20～10:30 高放熱性コンポジットの熱物性測定法 森川 淳子(東工大)

2 高放熱性コンポジット最前線:材料開発の概要と展望 第1部

- 10:30～ 2-01 熱伝導エポキシとコンポジット 竹澤 由高(日立化成)
- 10:50～ 2-02 CNT分散制御による絶縁樹脂の高熱伝導化技術 福森 健三(豊田中研)
- 11:10～ 2-03 主鎖型液晶ポリエステルによるマトリックス樹脂の高熱伝導化 吉原 秀輔(カネカ)
- 11:30～ 2-04 高熱伝導性樹脂の複合化技術と応用例 甲斐原将(ユニチカ)
- 11:50～ 2-05 高熱伝導性樹脂複合材料の開発 小野 義則(スターライト工業)
- 12:10～ 2-06 分子シミュレーション技術による高分子材料の熱伝導性予測 鵜崎晋也(三菱電機)

12:30～13:30 昼休み

高放熱性コンポジット最前線:材料開発の概要と展望 第2部

- 13:30～ 2-07 熱伝導性フィラー酸化マグネシウムの設計と特性 西田直人(宇部マテリアルズ)
- 13:50～ 2-08 放熱性フィラーとコンポジット 門田 健次(電気化学工業)
- 14:10～ 2-09 熱対策材料ソリューション 西川和宏(パナソニック)
- 14:30～ 2-10 可溶性液晶ポリマーを用いた高熱伝導基板の開発 岡本 敏(住友化学)
- 14:50～ 2-11 金属グラファイト複合熱拡散シート 藤原 武(JNC 石油化学)
- 15:10～ 2-12 高熱伝導窒化物セラミックス技術とその応用 白井 隆雄(東芝マテリアル)
- 15:30～ 2-13 高熱伝導度を有した水酸化マグネシウム
／グラファイト系複合化学蓄熱材料の開発 加藤 之貴(東工大)

15:50～16:10 休憩

3 サーマルマネジメント:パワーデバイスを中心に

- 16:10～ 3-01 エンジン制御用コンピュータの熱シミュレーション技術 篠田 卓也(デンソー)
- 16:40～ 3-02 照明用光源に求められる放熱技術 甲斐 誠(パナソニック)
- 17:10～ 3-03 パワエレ機器の高効率・小型化を実現する熱マネジメント技術 笹岡 達雄(パナソニック)

4 パネル討論 17:30～18:00

パネラー トヨタ自動車(株) 岡島博司 ほか
最新のサーマルマネジメントなど、熱を取り巻くトピックスに関して議論を深める。

5 立食パーティー 18:30-20:00

ロイヤルブルーホール(東工大蔵前会館, 大岡山駅前)

申込方法：右のサイトよりお申し込みください → <http://www.rs.tus.ac.jp/jstp2014/html/workshop.html>

問い合わせ先 特別ワークショップ世話役：上利泰幸(agari@omtri.or.jp), 安藤慎治 (sando@polymer.titech.ac.jp),
森川淳子 (morikawa.j.aa@m.titech.ac.jp)